

Title (en)
Sub-miniature D Connector for SMD-Technology

Title (de)
Sub-D-Stecker in SMD-Technik

Title (fr)
Connecteur subminiature de type D pour la technologie SMD

Publication
EP 0874421 A1 19981028 (DE)

Application
EP 98105336 A 19980324

Priority
DE 19717626 A 19970425

Abstract (en)
The plug, particularly of the so-called sub-D plug design, includes a base plate (5) which is designed so that the base plate can be mounted to a circuit board. The base plate has at least one projecting soldering lug (29,30) which is designed so that it can be soldered on a solder point provided on a circuit board by the surface mounting (SM) technique. Several projecting soldering lugs (29,30) are provided and are arranged adjacent to one another on at least one edge (27,28) of the base plate (5).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Sub-D-Stecker mit einer Grundplatte (5), die so ausgebildet ist, daß diese an einer Leiterplatte befestigbar ist. Beim erfindungsgemäßen Sub-D-Stecker (1) weist die Grundplatte (5) insbesondere wenigstens einen Lötvorsprung (29, 30) auf, der so ausgebildet ist, daß er mit einer SM-Löttechnik an einem auf einer Leiterplatte vorgesehenen Lötunkt anlötbar ist. Die Erfindung betrifft weiterhin Stecker, die im Hinblick auf einen günstigen Kraftfluß zwischen Stecker und Leiterplatte und im Hinblick auf einen einfachen Zusammenbau verbessert sind. Dadurch ist eine einfache Herstellung und eine unkomplizierte Montage des des Steckers gewährleistet, weil in einem Arbeitsgang der Stecker mechanisch und elektrisch mit einer Leiterplatte verbunden werden kann. <IMAGE>

IPC 1-7
H01R 23/70; **H05K 13/04**

IPC 8 full level
H01R 12/55 (2011.01); **H01R 12/71** (2011.01); **H01R 43/02** (2006.01); **H05K 13/04** (2006.01)

CPC (source: EP)
H01R 12/707 (2013.01); **H01R 12/724** (2013.01); **H01R 43/0256** (2013.01); **H01R 12/57** (2013.01)

Citation (search report)
• [XA] EP 0707359 A2 19960417 - MOLEX INC [US]
• [A] EP 0706314 A1 19960410 - MOLEX INC [US]
• [A] US 5186654 A 19930216 - ENOMOTO MASAHIRO [JP], et al

Cited by
DE102011107768A1; WO2013010525A1; DE102005048827A1; DE102018119998A1; EP3940889A1; CN103843204A; DE102011107768B4; US7048547B2; DE202011103356U1; US7690929B2; WO03047045A1; US10403994B2; US11652308B2; US9065206B2

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK FI FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0874421 A1 19981028; **EP 0874421 B1 20070620**; AT E365387 T1 20070715; DE 59814036 D1 20070802; JP H10302912 A 19981113

DOCDB simple family (application)
EP 98105336 A 19980324; AT 98105336 T 19980324; DE 59814036 T 19980324; JP 11529398 A 19980424